

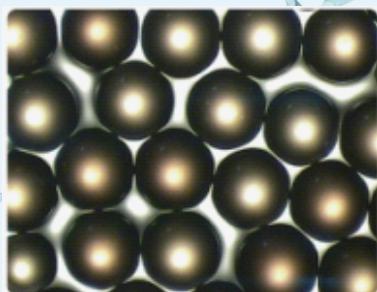


软化及超纯水精处理树脂



—— *HBF-007软化树脂*

Cation



—— *DWEP电子级离子交换树脂指*

Anion



—— *RHSP半导体级精炼树脂*



试验室用高效抛光树脂产品

1. 电子级树脂

1.1 电子级树脂规格表

序号	产品型号	品名描述	规格
1	FDP-MR3UPW	电子级树脂	5升/包
2	DWEP	电子级树脂	5升/包

1.2 电子级树脂参数表

性能	阳离子H ⁺	阴离子OH ⁻
基质	苯乙烯二乙烯基苯共聚物	
官能团	磺酸	季胺
外观	琥珀色透明圆球	黄色透明圆球
总交换容量	≥ 1.9 eq/L	≥ 1.0 eq/L
含水率	(46~51) %	(55~65) %
平均粒径	(650±50) μm	(590±500) μm

1.3 电子级树脂建议操作条件

进水温度	5°C~25°C (60°F~77°F)
最大操作温度	60°C (140°F)
最小床深	800mm
工作流量	40BV/hr

2. 半导体级树脂

2.1 半导体级树脂规格表

序号	产品型号	品名描述	规格
1	FRS-UP6040	半导体级树脂	5升/包
2	RHSP	半导体级树脂	5升/包

2.2 半导体树脂参数表

性能	阳离子H ⁺	阴离子OH ⁻
基质	苯乙烯二乙烯基苯共聚物	
官能团	磺酸	季胺
外观	琥珀色透明圆球	黄色透明圆球
总交换容量	≥ 2.0 eq/L	≥ 1.1 eq/L
含水率	(44~51) %	(54~60) %
平均粒径	(600~700) μm	(580~680) μm

2.3 半导体级树脂建议操作条件

进水温度	5°C~25°C (60°F~77°F)
最大操作温度	60°C (140°F)
最小床深	900mm
工作流量	30BV/hr~50BV/hr



3. 技术要求

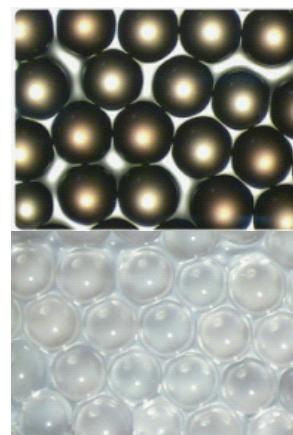
- 3.1 树脂外观及性能符合参数表要求；
- 3.2 树脂中无杂质及污染；
- 3.3 产品保持湿润，无干裂或结块现象；
- 3.4 装袋以实际5L树脂重量为标准，公差为±0.2kg；

RHSP半导体级精炼树脂

H.N.K RHSP 半导体级精炼树脂是一种专为水质要求超过 $18M\Omega$ 以上之超纯水系统所设计，其具有以下特性：

- 极佳的物理及化学稳定性。
- 较高的交换容量及交换速率 (H^+ Form ≥ 2.0 eq/L, OH^- Form ≥ 1.1 eq/L)
- 较低TOC及Silica的泄漏量。
- 较高的通水流量 (50 BV/hr), 凝胶型均球颗粒。
- 基于以上特性，使得RHSP可在消耗最少的清洗水下，达到超纯水的水质要求。

技术参数表		
特性	阳离子 H^+	阴离子 OH^-
基质	聚苯乙烯二乙烯基苯共聚物	
官能基	磺酸	季胺
型态	深琥珀色透明的珠子	黄色透明的珠子
总交换容量eq/L	≥ 2.0	≥ 1.1
含水量 %	44~51	54~60
平均粒径 μm	600~700	580~680
重量 g/L	710	
标准包装 L/桶	50	



操作条件建议	
进水温度	15~25°C (60~77°F)
最大操作温度	60°C (140°F)
最小床深	900mm (3feet)
供水流量	30BV/hr~50BV/hr



RHSP树脂适用于光电、封测、太阳能及LED...以下等相关电子产业，特别是水质要求在 $18M\Omega$ 以上之超纯水系统。（本树脂请勿使用于食品或饮用水相关制程）

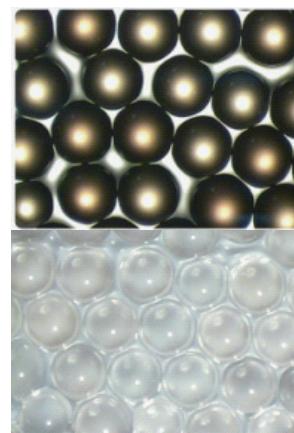


DWEP电子级离子交换树脂

H.N.K DWEP 电子级离子交换树脂可做为超纯水系统中精炼或混床树脂塔之使用，其具有以下特性：

- 颜色和粒径的差别使其能够有较好分离和再生效果。
- 较高的离子交换容量和优化体积比 (H^+ Form $\geq 1.9 \text{ eq/L}$ 、 OH^- Form $\geq 1.0 \text{ eq/L}$)。
- 较少有树脂凝结成团现象。
- 能够有效去除硼、矽...等离子。
- 高效的清洗能够使导电度和TOC达到期望值。

技术参数表		
特性	阳离子 H^+	阴离子 OH^-
基质	聚苯乙烯二乙烯基苯共聚物	
官能基	磺酸	季胺
型态	深琥珀色透明的珠子	黄色透明的珠子
总交换容量eq/L	≥ 1.9	≥ 1.0
含水量 %	46~51	55~65
平均粒径 μm	650 ± 50	590 ± 50
再生剂量	1.8% H_2SO_4 或 4.8% HCl	4%~8% NaOH
重量 g/L	689	
标准包装 L/桶	50	



操作条件建议	
进水温度	15~25°C (60~77°F)
最大操作温度	60°C (140°F)
最小床深	800mm
供水流量	40BV/hr



DWEP树脂适用于封测、太阳能及LED...以下等相关电子产业。
(本树脂请勿使用于食品或饮用水相关制程)

软化树脂—HBF-007

技术参数表	
名称	标准
基体	苯乙烯——二乙烯苯共聚物
功能基	磺酸根 HSO_3^-
外 观	浅棕黄色透明颗粒
出厂离子形态	Na^+ 型
质量全交换容量	$\geq 4.4 \text{ mmol/g}$
总交换容量	$\geq 1.7 \text{ mmol/ml}$
湿真密度	1.24~1.29g/ml
湿视密度	0.77~0.87g/ml
含水量	45~53%
粒度 (0.315mm~1.40mm) %	≥ 95
均一系数	≤ 1.9
磨后圆球率	≥ 85



HBF-007软化树脂适用于：锅炉软化水、洗涤印染软化水不、RO预处理软化水等

